DIVA Labs.

ECR (Engineering Change Request)

Proposed Change：	☐1. Design modification 設計修改 ☐2. Material change 材料變更 ☐3. Manufacturer change 製造商變更 ☐4. Factory change 工廠變更 ☐5. Process sequency change 工序變更 ☐6. Equipment / Tooling change 設備 / 模具變更 ☐7. Process / Method / Condition change 加工流程/方法 / 條件變更 ☐8.Add second source 新增替代料 ■9. Others 其他：_____	**Initiator：** Bu 0323 1500
Reason for Change：	原物料新增為專用料號（補發）	**EC No：** EC26030601
Model / Part No.：	RUP2732CMI / RUP2732CMI_CTD / RUP2433AMI / RUP2433AMI_D	**Issue Date：** 2026/3/9 **Requester Dept.：** DV11M016
Implementation Type：	■1. Immediately Change 立即切換 ☐2. Running Change 自然切換 ☐3. Other 其他：_____	**Customer Approval：** (confirmed by PM) ☐ Needed ■ Not needed

Material Change Description（Please add pages as needed if the provided space is insufficient.）
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁）

No.	Subassembly		Part No.	Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
~~2~~ 1 Bu 0309	2AAD462R13U	B						2nd 3D2020EH01Y181
		A	3D2020EH01Y181	DIODE (PMEG2020EH,SOD123F,SMD,NXP)	2	D1702,D1703		1st 3D2020EH01Y Bu 0309
		B						
		A						
		B						
		A						

Comments 會簽意見

Nexperia 物料 Philips 2027 使用需求，對沖 2AAD462R13U 03U 33U Terry 0310

R&D		Department 會簽部門								Approval
Initiator	Initiator's Direct Supervisor	DQE	PM	Sales	PE	PMC	SCM	PD	QA	R&D Director
Lewis 0309 1530 Bu 0309 1500	Michael 0309 1538 Lewis 0309 1530	Bill 0309 1530	Amber 0309 1535	Estela 0309 1515	[illegible] 0310 1030 Hanna 0310 0930	Terry 0310 [illegible] 0317	Mily 3/17	Howen 0310 1100 Joanne 0310 1035	[illegible] 0319 1550 [illegible]	Michael 0323 0800

ECR (Engineering Change Request)

Material Change Description (Please add pagesor row as needed if the provided space is insufficient.)
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁或增列）

No.	Subassembly	Part No.		Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
		B						
		A						
		B						
		A						

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List
工程變更評估項目清單

Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery 是否有修改交貨的規格或圖面	☐Yes ■No need	RD	無影響
2. Standards or Regulatories Impact 是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請	☐Yes ■No need	DQE	無影響
3. Change point of PCB mounting PCBA插件位置是否變更	☐Yes ■No need	RD	無影響
4. PCBA Process Changes PCBA製程是否變更	☐Yes (Continue checking below) ■No Mwin	PE	無影響
4-1) Change of Reflow temperature 迴焊溫度是否變更	☐Yes ■No need		無影響
4-2) Change of bonding temperature 膠合溫度是否變更	☐Yes ■No need		無影響
4-3) Change of Manual Soldering temperature 人工手焊工具之溫度是否變更	☐Yes ■No need		無影響
4-4) Change of storage condition after protection humidity package 防潮包裝完成後的儲存條件是否變更	☐Yes ■No need		無影響
5. Reliability test report (Test result and data) 是否有可靠性測試報告（測試結果及數據）	☐Yes ■No need	DQE	無影響
6. Process FMEA（Medical only） 是否有進行製程失效模式與效應分析	☐Yes ■No need Mwin	PE	無影響
7. Design FMEA（Medical only） 是否有進行設計失效模式與效應分析	☐Yes ■No need	RD	無影響
8. Risk Management（Medical only） 是否有進行風險管理評估	☐Yes ■No need	RD	無影響
9. Change points due to the modification 是否此修改會延伸導致其他變更點	☐Yes ■No need	RD	無影響

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List
工程變更評估項目清單

Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
10. Initial Supply Control implements plan or result. 是否有實施供料控制評估	☑Yes ☐No need	PMC	料件留設定.
10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change. 確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期。	☐Yes ☑No need		
10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials. 協調相關產品及材料處理方法。	☐Yes ☑No need		
10-3) Arrange the production schedule. 處理生產日程之安排。	☐Yes ☑No need		
10-4) Control the changed materials. 變更材料之管制。	☑Yes ☐No need		物料變更代碼 20181
10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material. 建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料。	☑Yes ☐No need		系統追溯.
11. Training Requirement 若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練	☐Yes ☑No need	PE	
12-1. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ QC control plan ☐ Service Manual ☐ Others	☐Yes ☑No need	QA	板階無影響
12-2. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ SIP ☐ SOP ☐ Others	☐Yes ☑No need	PE	
12-3. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ MDF ☐ DMR ☐ Approval Sheet ☐ Engineering Spec ☐ Others	☐Yes ■No need	RD / DQE	無影響

設計變更審查會議記錄

會議名稱	ECN/ECR	日期	2025/10/29	時間	16:00-17:00	地點	801 會議室
會議種類	例會						
主席	Terry	與會人員	Terry ,Estela ,Ryan ,Amber ,Ben				
會議記錄	PM	缺席人員	無				

主席指示事項：

No	工作項目	負責人
1.	ECR-新增客戶代碼 Keep Philips 專用物料。	**Ben**

決議事項：

No	工作項目	負責人	狀態
1.			

追蹤事項：

No	工作項目	負責人	完成日期	狀態	
1.					

會議記錄內容：

機種名稱: RUP2732CMI, RUP2732CMI_CTD, RUP2433AMI , RUP2433AMI_D

設計變更原因：保留專用料供 philips 使用, 料號新增 181 客戶代碼,

設計變更描述: 3D2020EH01Y 轉 Philips 專用料，料號追加客戶代碼 181 區分。

導入時程：Immediately Change.

客戶審查：Not needed

一. 研發課評估:

單位	審查內容	附加文件
EE :	因客人需求及同意下變更供應商,經評估,材料與設計都符合原設計,並不會造成產品功能,性能及安全性影響.	無
FW:	評估變更 DC JACK 與韌體設計無關,不會造成硬體安全性影響	無
ME:	評估變更 DC JACK 與機構設計無關,不會造成硬體安全性影響	無
SW:	評估變更 DC JACK 與軟體設計無關,不會造成硬體安全性影響	無
DQE:	此設計變更不會造成產品功能,性能及安全性影響,評估後無需進行相關驗證.	無

二 結論:

1. 僅物料控管調整 BOM，由入料區分料號 181 管控給 Philips 專用。
2. 開發單位各部門評估後,此設計變更不會對產品預期用途造成影響,
   設計變更風險審查於風險評估報告中呈現

功能	設計變更內容無關功能影響
性能	設計變更內容,無關產品性能影響
可用性	無影響,沒有使用上的風險
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險,
法規	經審查,沒有影響法規內容